

电容检测电子元器件

产品名称	电容检测电子元器件
公司名称	深圳讯科标准技术服务有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 18002557723

产品详情

电子元器件是元件和器件的总称。 电子元件：指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品，元件属于不需要能源的器件。它包括：电阻、电容、电感等。(又称为被动元件Passive Components) 电子器件：工厂在生产加工时改变了原材料分子结构的产品称为器件。电子器件分为： 1、分立器件，分为(1)双极性晶体管(2)场效应晶体管(3)可控硅(4)半导体电阻电容； 2、主动器件(又称为有源器件)，是指电路中含有放大控制元(如半导体、三极管、MOS管等)的电路器件，主动器件需要外部提供电源才能工作。

集成电路，英文为Integrated Circuit，缩写为IC；顾名思义，就是把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路。

检测范围

电子元器件：电阻器、电容器、电感器、场效应晶体管、三极管、二极管、电连接器等；

集成电路：数字集成电路(小规模集成电路及大规模集成电路)、半导体集成电路等。

检测项目

环境可靠性、机械、物理和寿命试验。

相关检测标准

GJB360B 电子及电气元件试验方法 温度冲击试验

GB/T 2423.11 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Fd:宽频带随机振动--一般要求

GJB 360A 电子及电气元件试验方法

GJB 1420A 半导体集成电路外壳总规范

GJB 128A 半导体分立器件试验方法

GJB 3157 半导体分立器件失效分析方法和程序

GJB 3233 半导体集成电路失效分析程序和方法

GJB 548A 微电子器件试验方法和程序

GJB 548B 微电子器件试验方法和程序

GJB 5914 各种质量等级半导体器件破坏性物理分析方法

GJB128A 半导体分立器件试验方发方法1071密封

GB/T17574半导体器件集成电路 第2部分：数字集成电路

GJB597A 半导体集成电路总规范

GB/T6798半导体集成电路电压比较器测试方法的基本原理

GB/T4587半导体分立器件和集成电路 第7部分:双极型晶体管

GB/T4586半导体器件分立器件第8部分：场效应晶体管

GB/T 4023 半导体器件:分立器件和集成电路第2部分:整流二极管

GB/T2693 电子设备用固定电容器 部分：总规范

GB/T5729 电子设备用固定电阻器 部分：总规范

GJB1217A 电连接器试验方法等。